

株式会社 クラベ御中

住所

社名

所属・役職

責任者名

印

使用禁止化学物質不使用に関する保証書

当社は、株式会社クラベに納入する下記対象製品について株式会社クラベが下記に指定する使用禁止化学物質を意図的に不使用なことおよび不純物につきましては下記基準値以下で管理していることを保証致します。

対象製品

表-1.指定禁止化学物質リスト

No.	化学物質名	基準値
1	カドミウム及びその化合物	※1
2	鉛及びその化合物	※2
3	水銀及びその化合物	1000ppm 未満
4	六価クロム化合物	クロメート処理: 100ppm 未満 その他 1000ppm 未満
5	ポリ臭化ビフェニル類(PBB)	1000ppm 未満
6	ポリ臭化ビフェニルエーテル類(PBDE)	1000ppm 未満
7	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	意図的添加の禁止
8	ポリ塩化ナフタレン(PCN)	意図的添加の禁止
9	ポリ塩化パラフィン(CP)	意図的添加の禁止(C=10~13 が対象)
10	砒素及びその化合物	意図的添加の禁止
11	三置換有機スズ化合物 (TBT 類、TPT 類、TBTO 類、その他の三置換有機スズ化合物)	1000ppm 未満 (金属換算)
12	二置換有機スズ化合物 (DBT 類、DOT 類)	1000ppm 未満 (金属換算)
13	石棉	意図的添加の禁止
14	アゾ化合物	発生する特定アミン(表-2)が 30ppm 以下は除外とする
15	ホルムアルデヒド	意図的添加の禁止
16	オゾン層破壊物質 ※3	意図的添加の禁止
17	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びその塩類	意図的添加の禁止
18	フマル酸ジメチル (DMF)	0.1ppm 未満
19	特定ベンゾトリアゾール	意図的添加の禁止

- ※1 プラスチック・ゴム・塗料・インキ 5ppm 未満 鉛フリー半田 20ppm 未満
亜鉛合金 75ppm 未満 その他の金属材料 75ppm 未満 その他の材料 75ppm 未満
- ※2 ゴム・プラスチック・塗料・インキ 100ppm 未満 鉛フリー半田 基板用端子 1000ppm 未満
芯線端末処理用・その他金属材料 500ppm 未満 その他の材料 1000ppm 未満
- ※3 モントリオール議定書 Class I, II の物質

表-2. 特定アミン類

4-アミノフェニル	4,4'-ジアミノフェニルメタン	4,4'-チオジアニン
ベンジジン	3,3'-ジクロロベンジジン	o-トルイジン
4-クロロ-o-トルイジン	3,3'-ジメチルベンジジン	2,4-トルイレンジアミン
2-ナチルアミン	3,3'-ジメチルベンジジン	2,4,5-トリメチルアニン
o-アミノアゾトルエン	3,3'-ジメチル-4,4'-ジアミノフェニルメタン	o-アニジン
2-アミノ-4-ニトロトルエン	p-クレジジン	4-アミノアゾベンゼン
p-クロロアニン	4,4'-メチレンビス-(2-クロロアニン)	
2,4-ジアミノアニール	4,4'-オキシジアニン	

表-3.適用除外リスト

化学物質	除外項目
鉛及びその化合物	電子セラミックス部品及び電子部品のガラス中の鉛
	マイクロプロセッサのピンとパッケージ間接合用のはんだ中の鉛
	高融点半田に含まれる鉛
	集積回路パッケージ（フリップチップ）の内部半導体ダイ及びキャリア間における確実な電気接続に必要なはんだに含まれる鉛
	合金中の鉛（銅合金 4.0wt%未満 鋼材 0.35wt%未満 アルミニウム合金 0.4wt%未満）
カドミウム及びその化合物	電気接点のカドミウム
DBT 類（ジブチルスズ化合物）	1成分、2成分室温硬化シーラント（RTV-1、RTV-2）接着材
	製造中に使用され、触媒としてジブチルスズ化合物を含むペイント及びコーティング
	軟質ポリ塩化ビニル（PVC）異形品、単独または硬質 PVC との共押出のいずれも
DOT 類（ジオクチルスズ化合物）	皮膚に触れる繊維製品
	2成分室温硬化モールドキット（RTV-2 モールドキット）